

FPC薄型化により狭スペース組付けに有効！ 低スプリングバック、高屈曲性が要求される箇所

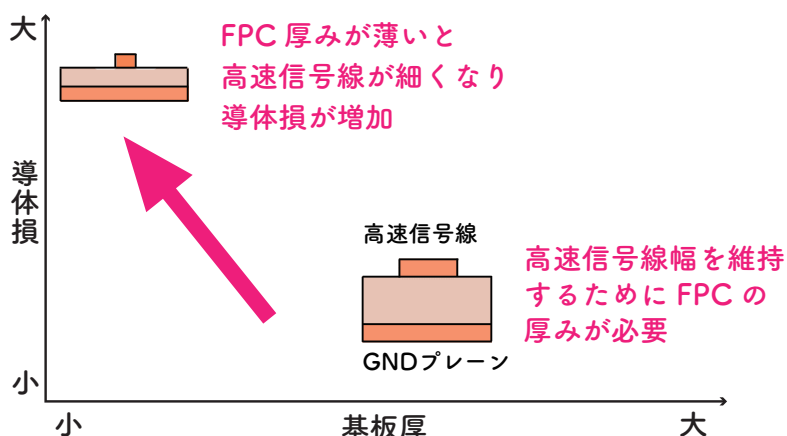
産学公連携事業化促進研究【青山学院大学、KISTEC 電子技術部、山下マテリアル株式会社】
《高速伝送用 FPC の製造技術及び電磁ノイズ低減技術の研究開発》

製品特徴

- マイクロストリップラインの課題である、FPC の厚みと導体損の関係を解消させる現在研究開発中の技術です。
- グラウンド(GND)プレーンにスリットデザインを設けることにより伝送特性を維持したまま、FPC の薄型化実現が期待できます。

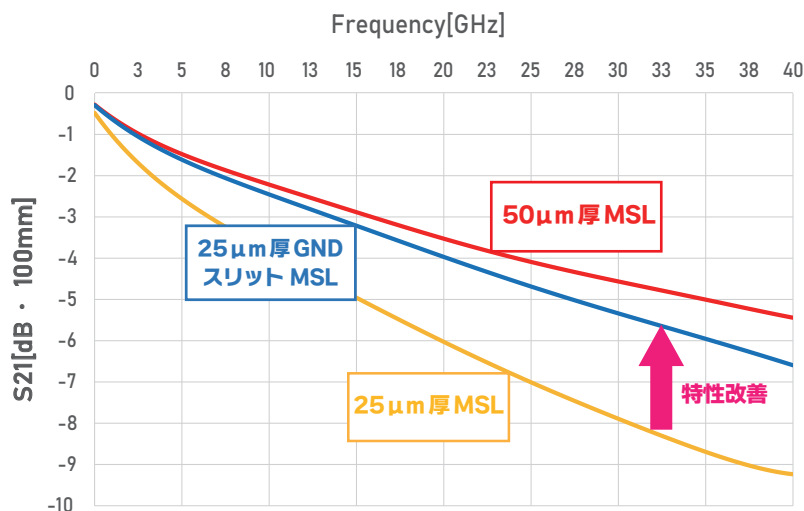
マイクロストリップライン (MSL) 構造の課題

従来のマイクロストリップラインの構造では FPC の厚みを薄くすると高速信号線幅が細くなり、導体損が大きくなるため、伝送特性を維持したまま薄型化にすることが困難



伝送特性(S21 測定)

伝送特性を維持したまま薄型化の実現が可能！



スリット構造例

